

特点:

- 输出频率范围: 2200MHz~5400MHz
- 最小调谐步进: 100Hz
- 3 线 SPI 串口控制
- SMT 封装
- 封装尺寸: 25.4×20.3×4.6mm(E 型)
- 产品执行标准为 GJB8481-2015

电性能参数: (25℃)

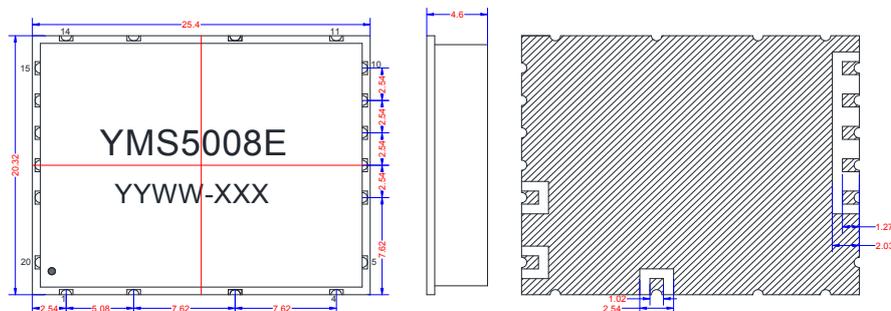
参数名称	符号	参数值			单位	备注
		MIN	TYP	MAX		
参考输入频率范围	F_{ref}		100		MHz	
参考输入功率	V_{ref}	0.7		2	V	
输出频率	F_{out}	2200		5400	MHz	
输出功率	P_{out}	0	5		dBm	
杂散抑制	SR	38	43		dBc	
频率跳变步进	I_{fc}	100			Hz	
跳频时间	T		65	80	us	3.8G to 5.4G
相位噪声			-97	-95	dBc/Hz	5G @10K
锁定检测	锁定 2.4VMin, 失锁 0.6VMax				V	
电源电压	V_{cc}	+5		+6	V	
电源电流	I_{cc}		320	400	mA	
质量			5	10	g	
工作温度	T	-40		+85	℃	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
电源电压	6	V	贮存温度	-55~+100	℃

封装外形图:

单位: mm 公差: ±0.2mm



字符标志:

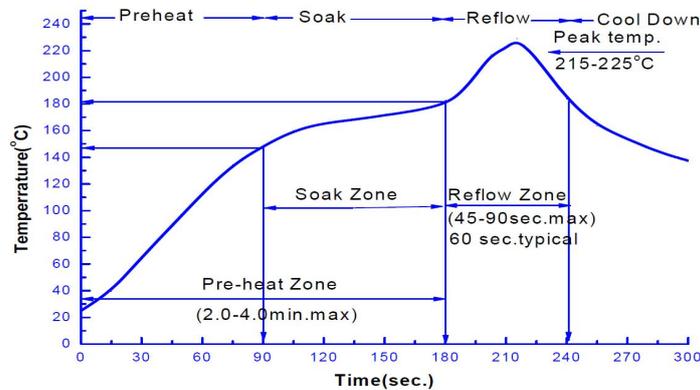
YMS5008E	产品型号
●	1脚
YYWW	批次号
XXX	序列号

引脚定义:

引脚	符号	定义
3	V _{CC}	电源端
5	LD	锁定指示端
6	RF _{out}	射频输出端
15	REF _{in}	参考输入端
16	CLK	SPI 串口时钟
17	DATA	SPI 串口数据
18	LE	SPI 串口片选
19	NC	悬空
其余	GND	地

产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

4. 如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 产品在焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。
7. 该产品为非密封器件，对于有高可靠性盐雾要求的环境，客户在产品应用时应结合实际环境确定防护方案，建议对应用的模块或整机进行密封处理，或选用我司满足气密性封装的产品。